



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20111010001

2011 年 10 月 12 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

データシート訂正(THS4502/3 製品)のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	☒ Design/Specification	☐ Design	☒ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	データシート 4 項目の記載訂正 現行 : 4 項目の記載 変更後 : 4 項目の記載訂正			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	データシート訂正は 10 月上旬に実施済みです。 2012 年 1 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：発行済みのデータシートに訂正箇所がありその訂正をお知らせするものです。弊社 HPA(ハイパフォーマンシアナログ) THS4502/3製品について、製品特性をより反映する為に、データシートの記載訂正を実施しました。尚、今回の変更で訂正対象項目を除き、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

理由：製品特性をより反映する為

対象製品リスト

対象製品名				
THS4502CD	THS4502IDG4	THS4502IDR	THS4503CDGNRG4	THS4503IDGNR
THS4502CDG4	THS4502IDGK	THS4502IDRG4	THS4503ID	THS4503IDGNRG4
THS4502CDGN	THS4502IDGKG4	THS4503CD	THS4503IDG4	THS4503IDR
THS4502CDGNG4	THS4502IDGN	THS4503CDG4	THS4503IDGK	THS4503IDRG4
THS4502CDGNR	THS4502IDGNG4	THS4503CDGN	THS4503IDGKG4	
THS4502CDGNRG4	THS4502IDGNR	THS4503CDGNG4	THS4503IDGN	
THS4502ID	THS4502IDGNRG4	THS4503CDGNR	THS4503IDGNG4	

詳細：

1. Datasheet# THS4502/3 SLOS352D → SLOS352E
<http://www.ti.com/product/th4502>

Item	Page/Location	Description of Change
C.1	Page 35, REVISION HISTORY	Revised revision history from Rev-D to Rev-E.

C.1 Pg 35, REVISION HISTORY

REVISION HISTORY

Changes from Revision D (January 2004) to Revision E	Page
• Added WARNING to DESCRIPTION	1
• Added Maximum junction temperature to prevent oscillation, T _j and footnote to ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS	3
• Deleted power rating and footnote from PACKAGE DISSIPATION RATINGS	3
• Added MAXIMUM DIE TEMPERATURE TO PREVENT OSCILLATION section	21

変更内容の詳細はデータシートを参照下さい。上記記載の REVISION HISTORY において各変更箇所へのハイパーリンクが施されています。